

M1FP3

30V 1.29A

特長

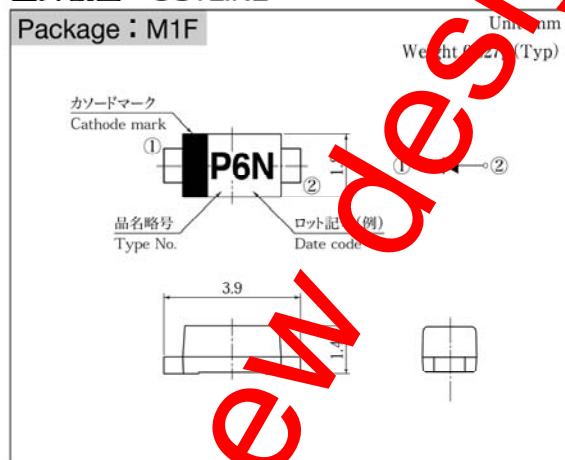
- 小型SMD
- 超低VF=0.4V

Feature

- Small SMD
- Ultra-Low VF=0.4V

用途

- バッテリー逆接防止
- DC出力OR用
- DC/DCコンバータ
- 携帯電話、パソコン
- Reverse connect protection for DC power source
- DC OR-output
- DC/DC Converter
- Mobile phone, PC

Main Use**■外観図 OUTLINE****■定格表 RATINGS****●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 Tj = 25°C)**

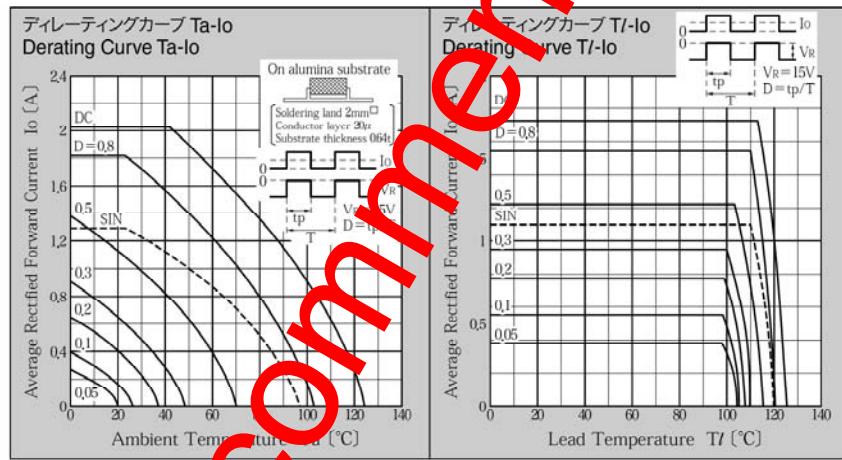
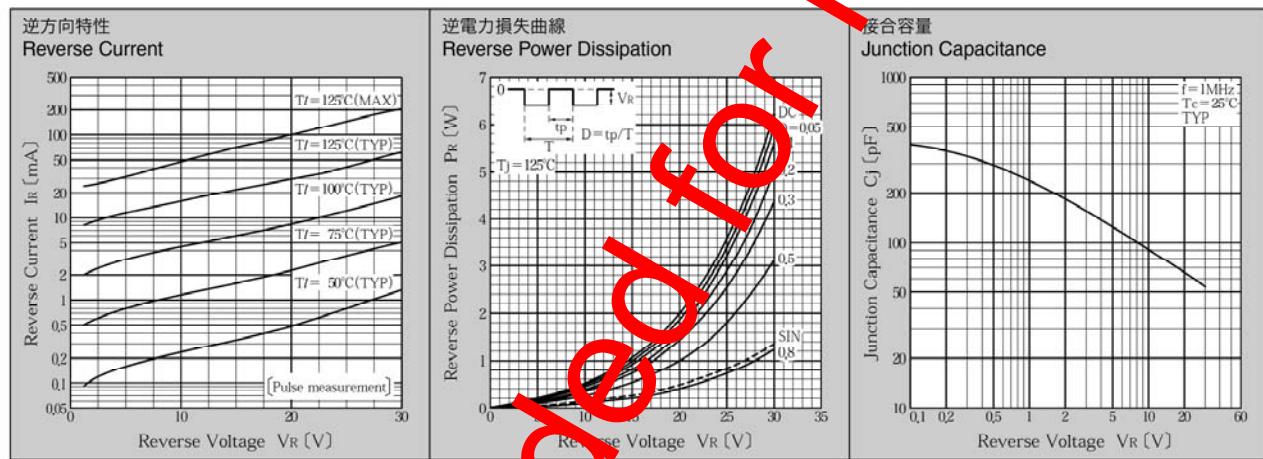
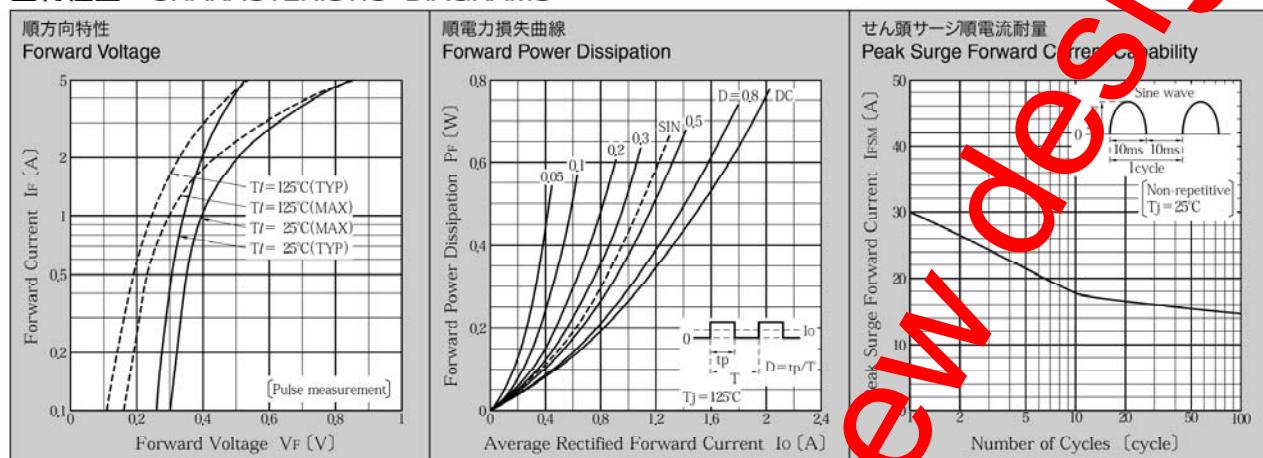
項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	M1FP3	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-55~125	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			125	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			30	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistive load	T _a = 25°C アルミナ基板実装 Ta = 25°C On alumina substrate	1.29	A
せん頭サーボ電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返しサイクルせん頭値, T _j = 25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, T _j = 25°C	T _a = 109°C On glass-epoxy substrate	1.1	
				30	A

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 Tj = 25°C)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F = 0.4A, パルス測定 Pulse measurement	MAX 0.35	V
		I _F = 1.1A, パルス測定 Pulse measurement	MAX 0.40	
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R = V _{RM} , パルス測定 VR = VR, Pulse measurement	MAX 2.5	mA
接合容量 Junction Capacitance	C _j	f = 1MHz, V _R = 10V f = 1MHz, VR = 10V	TYP 90	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jl}	接合部・リード間 Junction to lead	MAX 20	°C/W
	θ _{ja}	接合部・周囲間 Junction to ambient	MAX 108 MAX 186	
		アルミナ基板実装 On alumina substrate		
		プリント基板実装 On glass-epoxy substrate		

Small SMD

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine waveは50Hzで測定しています。
 * 50Hz sine wave is used for measurements.
 * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。
 Typicalは統計的な実力を表しています。
 * Semiconductor products generally have characteristic variation.
 Typical is a statistical average of the device's ability.